

2013-2014年全球及中国IC载板行业研究报告

《2013-2014年全球及中国IC载板行业研究报告》包含以下内容:

- 1、全球半导体产业现状
- 2、IC载板简介
- 3、IC载板市场分析
- 4、IC载板产业分析
- 5、11家IC载板厂家研究
- 6、全球前4大IC封装厂家研究
- PCB行业可分硬板（Rigid PCB）、软板（FPCB）、载板（Substrate）三大类。IC载板行业在2012和2013年两年连续下滑，根源在两方面：一是因为PC出货量下降，而CPU用载板是IC载板的主要类型，是单价（ASP）最高的载板；二是韩国企业为压制日本和台湾IC载板厂家的发展，大幅度降价，尤其是三星旗下的三星电机（SEMCO）大幅度降价近30%。这导致2013年全球IC载板行业市场规模下跌10.3%，至75.68亿美元。不过苦尽甘来，预计2014和2015年IC载板行业将迎来增长。
- 2014年增长的动力有几方面。首先是联发科的8核芯片MT6592采用FC-CSP封装，该芯片在2013年10月推出，预计2014年出货量会大增。随着联发科进入28nm时代，联发科会全面采用FC-CSP封装，接下来中国大陆的展讯也会采用。其次是LTE 4G网络开始兴建，BASESTATION 芯片需要IC载板。

- 其三，是可穿戴设备（wearable devices）大量进入市场，这会刺激SiP模块封装，也需要IC载板。其四是手机追求超薄，就需要芯片具备良好的散热，FC-CSP封装在散热和厚度方面优势明显，未来手机的主要芯片都会是FC-CSP封装或SiP模块封装，包括电源管理和存储器。
- 其五，PC行业在2014年复苏。平板电脑在2014年高增长不再来，甚至会下滑，消费者意识到平板电脑只能做玩具，完全无法和PC比性能，PC行业将复苏。最后三星电机（SEMCO）不再杀价竞争，因为苹果下一代处理器A8确定会由台湾TSMC代工，而非三星电子代工。三星电机（SEMCO）即便杀价，也不可能让台湾TSMC给予其订单。
- 预计2014年全球IC载板行业市场规模增长9.8%，2015年会加速增长，增幅达11.6%。
- IC载板行业可以分为日韩台三大阵营。日本企业是IC载板的开创者，技术实力最强，掌握利润最丰厚的CPU载板。韩国和台湾企业则依靠产业链配合，韩国拥有全球70%左右的内存产能，三星一直为苹果代工处理器，三星也能够生产部分手机芯片。
- 台湾企业则在产业链上更强大，台湾拥有全球65%的晶圆代工产能，80%的手机高级芯片由台湾TSMC或UMC代工，这些代工的利润率远高于传统电子产品的利润率，毛利率在50%以上。以联发科的MT6592为例，代工由TSMC或UMC完成，封装由ASE和SPIL完成，载板由景硕提供，测试由KYECC完成，这些厂家都在一个厂区内，效率极高。
- 大陆企业在产业链完全没有任何优势，缺乏晶圆代工厂家和封装厂家支持，落后台湾数年乃至十几年。即便有海思和展讯这样出货量不低的大陆企业，台湾厂家仍然占据供应链的话语权。



2010-2014年主要IC载板厂家收入

	2010	2011	2012	2013	2014E
UNIMICRON	983	910	925	747	790
IBIDEN	1581	1602	1650	1110	1230
NANYA	914	980	645	702	908
KINSUS	556	794	694	746	820
SEMCO	927	1144	1230	1020	1008
SHINKO	1133	1059	870	980	1009
SIMMTECH	264	294	336	316	380
DAEDUCK	136	230	275	258	240
NGK	450	220			
KYOCERA	330	302	286	260	308
LG	130	146	110	145	159
INNOTEK					
ASE			174	192	218
Others	479	560			

单位：百万美元



报告目录

第一章、全球半导体产业

- 1.1、全球半导体产业概况
- 1.2、IC封装概况
- 1.3、IC封测产业概况

第二章、IC载板简介

- 2.1、IC载板简介
- 2.2、FLIP CHIP IC 载板
- 2.3、IC载板趋势

第三章、IC载板市场与产业

- 3.1、IC载板市场
- 3.2、手机市场
- 3.3、WLCSP市场
- 3.4、PC市场
- 3.5、平板电脑市场
- 3.6、FPGA与CPLD市场
- 3.7、IC载板产业
- 3.8、晶圆代工FOUNDRY市场规模
- 3.9、晶圆代工行业竞争分析

第四章、IC载板厂家研究

- 4.1、欣兴
- 4.2、IBIDEN
- 4.3、大德电子
- 4.4、SIMMTECH
- 4.5、LG INNOTEK
- 4.6、SEMCO
- 4.7、南亚电路板
- 4.8、景硕KINSUS
- 4.9、SHINKO
- 4.10、KYOCERA SLC
- 4.11、AT&S

第五章、IC载板封装厂家研究

- 5.1、日月光
- 5.2、AMKOR
- 5.3、矽品精密
- 5.4、星科金朋
- 5.5、三菱瓦斯化学



图表目录

- 2009-2014年全球半导体产业季度收入
- 2008-2017年全球半导体产业年度收入
- 2012-2017年全球半导体市场产品分布
- 2012-2017年各种半导体产品市场规模增幅
- 主要电子产品使用IC的封装类型
- 2012-2017年全球IC Packaging and Test市场规模
- 2012-2017年全球Outsourcing IC Packaging and Test市场规模
- 2012-2017年全球IC Packaging 市场规模
- 2012-2017年全球IC Test市场规模
- 2009-2013年台湾封测产业收入
- 2013年全球前10大封装企业收入
- 2009-2016年IC载板市场规模
- IC载板具体应用产品
- 2011-2016 IC载板 by node
- 2007-2015年全球手机出货量
- Worldwide Smartphone Sales to End Users by Vendor in 2013 (Thousands of Units)
- Worldwide Smartphone Sales to End Users by Operating System in 2013 (Thousands of Units)
- Worldwide Mobile Phone Sales to End Users by Vendor in 2013 (Thousands of Units)
- 2010-2016年WLCSP封装市场规模
- 2010-2016年WLCSP出货量下游应用分布



- 2008-2015年全球PC用CPU与Discrete GPU 出货量
- 2011-2016年全球平板电脑出货量
- 2013年平板电脑主要品牌市场占有率
- 2012、2013年全球平板电脑制造厂家产量
- 2011年FPGA、CPLD市场下游分布与地域分布
- 1999-2013年主要FPGA厂家市场占有率
- 2010-2014年主要IC载板厂家收入
- 2008-2017年全球Foundry市场规模
- 2012-2017 Foundry Revenue of Advanced Nodes
- 2012-2018 Global Foundry capacity by node
- 2012-2018 Global Foundry revenue by node
- Global ranking by foundry
- 2003-2014年欣兴收入与毛利率
- 2009-2014年欣兴收入与营业利润率
- 2012年1季度-2014年1季度欣兴季度收入与毛利率
- 2010-2014年欣兴销售额技术分布
- 2010-2014年欣兴收下游应用分布
- 2010-2014欣兴产能Capacity
- 2004-2013年欣兴CAPEX
- 欣兴历年合并
- 2012年2季度-2014年1季度IBIDEN季度收入业务分布
- 2012年2季度-2014年1季度IBIDEN季度营业利润业务分布



- 2010-2015财年ibiden电子事业部收入产品分布
- 2010-2015财年ibiden CAPEX与depreciation
- SIMM TECH组织结构
- 2009-2013年SIMMTECH资产负债表
- 2013年1季度-2014年4季度SIMMTECH季度收入产品分布
- 2012-2015年SIMMTECH收入产品分布
- 2013年1季度-2014年4季度SIMMTECH季度毛利率与运营利润率
- 2013年1季度-2014年4季度SIMMTECH季度出货量
- 2012-2015年SIMMTECH出货量
- 2013年1季度-2014年4季度SIMMTECH季度产能利用率
- 2012-2015年SIMMTECH产能利用率
- 2008-2014年SIMMTECH收入by application
- 2012-2014年SIMMTECH Substrate收入by application
- 2006-2014年LG INNOTEK收入与运营利润率
- 2013-2015年SEMCO IC Substrate sales by technology
- 2013-2015年SEMCO IC Substrate operatio profit by technology
- 南亚电路板组织结构
- 2006-2014年南亚电路板收入与毛利率
- 2009-2014年南亚电路板收入与营业利润率
- 2012年5月-2014年5月南亚电路板每月收入与增幅
- 2004-2014年景硕收入与毛利率
- 2009-2014年景硕收入与营业利润率



- 2012年5月-2014年5月景硕每月收入与增幅
- 2011-2014年景硕收入产品分布
- 2011年景硕收入下游应用分布
- Q1/2014景硕收入BY Applications
- 2013\2014 KINSUS客户分布
- 2007-2015财年Shinko收入与净利润
- 2010-2014财年Shinko收入业务分布
- 2005-2014财年 AT&S与EBITDA率
- AT&S重庆substrate厂ramp
- FY2014 AT&S收入地域分布
- FY2014 AT&S资产负债表
- 20092-2014年日月光收入与营业利润率
- 2012年5月-2014年5月日月光月度收入
- 2010-2013年ASE收入业务分布
- 2013年1季度-2014年1季度ASE封装部门收入与毛利率
- 2013年1季度-2014年1季度ASE封装部门收入类型分布
- 2013年1季度-2014年1季度ASE材料部门收入与毛利率
- 2013年1季度-2014年1季度ASE EMS收入与毛利率
- 2013年1季度-2014年1季度ASE EMS收入breakdown
- 2014年1季度ASE收入下游应用
- 2007-2012年Amkor收入封装类型分布
- 矽品精密工业组织结构



- 2012年5月-2014年5月SPIL月度收入
- 2012年1季度-2014年1季度SPIL季度收入、毛利率与营业利润率
- 2005-2014年矽品收入地域分布
- 2005-2014年矽品收入下游应用分布
- 2005-2014年矽品收入业务分布
- 矽品2006-2014年产能统计
- 三菱瓦斯化学Organization Chart
- 2009-2015财年MGC收入与营业利润
- 2009-2015财年MGC收入by segment
- 2009-2015财年MGC operation income by segment
- 2011-2014年全球3G/4G手机出货量地域分布
- 欣兴组织结构
- 2006-2015财年IBIDEN收入与运营利润率
- 2006-2015财年IBIDEN收入业务分布
- 2005-2014年大德电子收入与运营利润率
- 2009-2014年大德电子收入by business
- 2004-2014年SIMMTECH收入与运营利润率
- 2009-2014年SIMMTECH收入、毛利率与净利率
- SIMMTECH厂区
- 2011年1季度-2014年1季度LG INNOTEK收入与运营利润率
- 2011-2014年LG INNOTEK 收入业务分布
- 2011-2013年LG INNOTEK 运营利润业务分布



- 2010-2014年SEMCO收入部门分布
- 2012-2014年SEMCO营业利润部门分布
- 2013年1季度-2014年4季度SEMCO ACI事业部收入与运营利润率
- 南亚电路板产能与全球分布
- 日月光组织结构
- 2001-2014年日月光收入与毛利率
- 2005-2014年Amkor收入与毛利率、运营利润率
- 2003-2014年矽品收入、毛利率、运营利润率
- 2004-2014年星科金朋收入与毛利率
- 2006-2013年星科金朋收入封装类型分布
- 2006-2013年星科金朋收入下游应用分布
- 2006-2013年星科金朋收入 地域分布



购买报告

价 格	电子版: 8000元	电话: 010-8260.1561
	纸质版: 8500元	传真: 010-8260.1570
页数: 100页		邮箱: hanyue@waterwood.com.cn
发布日期: 2014-7		网址: www.pday.com.cn
链接: http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201407/24511809.html		
地址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、
联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-
82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561

传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

